

技 術 講 演 会

開 催 案 内

演 題 ナノ粒子応用の低温硬化・高導電性ペーストと
ファインライン形成

講 師 藤倉化成株式会社 電子材料事業部
技術開発部 部長 本多 俊之 氏

日 時

平成16年5月11日(火)
14時から16時

場 所

ホテルブエナビスタ 3F 鳳凰の間
松本市本庄1-2-1 電話 0263-37-0111

受講のおすすめ

導電性ペーストは塗布と硬化の二工程のみで導電性被膜が作成できるものです。電子回路の電極や部品実装等に使用され、真空やウェットプロセスを必要としない、アディティブ工法であるため廃棄部分が非常に少ない、導電性ペーストの特徴に合致した用途では非常に安価で生産性の高い工程が実現できる、等の特徴を持ちます。最近になって200 前後かそれ以下の低温で、アルミニウムに匹敵する高導電性の被膜が実現できる材料が多数発表され、各方面のアプリケーションでブレイクスルーが期待されています。

このような状況の中、藤倉化成株式会社様では独自の新しい導電性発現機構を持った材料を発表し、各種アプリケーションへの応用を図っています。本講演ではこの材料の原理を解説していただくと共に、特に力を注いでいる印刷によるファインライン形成の試みについても紹介していただきます。

導電性ペーストを、電子回路のシールド、電極、部品実装等に利用する方々ばかりでなく、ファインパターンのプリント配線板に応用されようとしている方々にもご聴講いただき、今後の活動にお役立てくださるようご案内します。

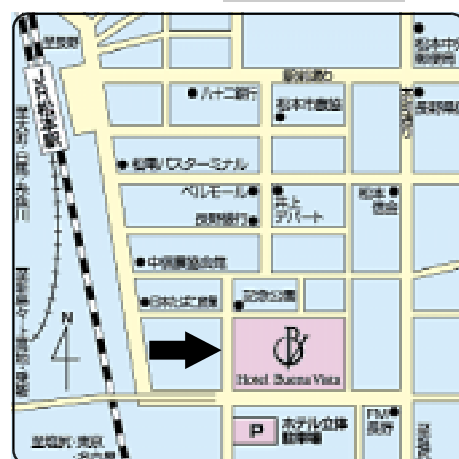
参加費 会員：無料、非会員：3,000円 **定員** 60名

会場案内

申込先 長野県情報技術試験場 設計技術部内
長野県電子回路技術研究会事務局
担当 村石道弘
TEL 0263-25-0997(ダイヤルイン)
FAX 0263-26-5350
E-Mail muraishi@nagano-it.go.jp
URL <http://www.kairoken.gr.jp/>

申込方法 E-MailまたはFAXでお申し込みください

締切日 平成16年5月6日(木)



主 催 長野県電子回路技術研究会

後 援

長野県情報技術試験場

長野県情報技術試験場 設計技術部内
長野県電子回路技術研究会 行

F A X 0 2 6 3 - 2 6 - 5 3 5 0
E-Mail muraishi@nagano-it.go.jp

技術講演会参加申込書

平成16年(2004年) 月 日

テーマ：ナノ粒子応用の低温硬化・高導電性ペーストとファインライン形成

日時：平成16年(2004年)5月11日 14:00~16:00

場所：ホテルブエナビスタ 3F 鳳凰の間

(松本市本庄1-2-1 電話 0263-37-0111)

連絡者	会社名	
	所在地	
	電話	
	氏名	
	E-Mail	

上記講演会に以下____名の参加を申し込みます。

参加者	
所属	氏名